



电子

优于大市（维持）

证券分析师

陈海进

资格编号：S0120521120001

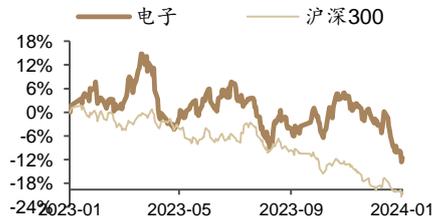
邮箱：chenhj3@tebon.com.cn

陈瑜熙

资格编号：S0120524010003

邮箱：chenyx5@tebon.com.cn

市场表现



相关研究

- 《小米汽车即将跨越登场，万事俱备待明日春风》，2024.1.17
- 《2023 年年度业绩预增公告点评-均胜电子 (600699.SH)：全年业绩有望超预期，长期成长动力充足》，2024.1.17
- 《洁美科技(002859.SZ)：Q4 业绩符合预期，离型膜成长拐点即将到来》，2024.1.16
- 《存储价格周度跟踪-0115：DRAM 料号持续上涨，模组 24 年指引乐观》，2024.1.15
- 《电子周观点：CES 展示 AI+ 的无限可能，问界成 24 年首周销冠》，2024.1.14

鸿蒙生态汇成璀璨星河，生态链 IC 设计公司开启成长新纪元

投资要点：

- **事件：**2023 年 1 月 18 日于深圳举办的鸿蒙生态千帆启航仪式上，余承东宣布 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版正式开放申请。经过数年的发展和蝶变，在众多伙伴和开发者的共同努力下，鸿蒙生态大势已定，截至目前，生态设备数已突破 8 亿台，较 2023 年 8 月的 7 亿台有较大增长。
- **从兼容走向独立，“纯血鸿蒙”正式起航。**自 2019 年鸿蒙操作系统 HarmonyOS 发布，到如今更新迭代至 4.0 版本，为保证日常使用，用户版本均可兼容安卓应用。此次发布会新推出的 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版完全采用自研底座，涵盖盘古 AI 大模型、MindSpore AI 框架、方舟编译器、鸿蒙内核等等从编程语言到编译器的全栈自研技术。基于此，HarmonyOS NEXT 将不再支持传统的 Linux 内核和 AOSP 安卓开放源代码项目，鸿蒙和安卓应用将不再兼容。此前，华为已于 1 月 15 日开启了 HarmonyOS NEXT 开发者预览版 Beta 招募，该预览版已不再兼容安卓开源应用，并支持华为 Mate 60、Mate 60 Pro、Mate X5 机型报名。从兼容走向独立的路上，鸿蒙内核依托于自研技术超越传统内核，更适应多样化、全场景的应用设备，构建起强大的核心技术优势。在 HarmonyOS NEXT 加持下，华为带领合作伙伴逐步构建起星河璀璨的国产操作系统生态圈。
- **原生体验至上，HarmonyOS NEXT 原生应用欣欣向荣。**鸿蒙星河版将实现原生精致、原生应用、原生流畅、原生安全、原生智能、原生互联等六大极致原生体验。对于开发者而言，鸿蒙星河版提供了各种工具和能力，降低了开发成本，提高了开发效率。对用户来说，鸿蒙星河版的新特性和技术优势将带来更好的应用体验。首批 200+ 原生应用已启动开发，覆盖便捷生活、出行文旅、金融理财、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等领域。其中，已有 100+ 原生应用完成了鸿蒙原生应用 Beta 版本，鸿蒙生态建设取得了显著进展。展望未来，鸿蒙生态正迈入第二阶段，计划年底启动 5000+ 原生应用开发，最终目标达到 50 万+ 应用。
- **鸿蒙生态链 IC 设计公司持续蓄力，HarmonyOS NEXT 有望开启成长新纪元。**鸿蒙系统是一个开放的物联网生态，各物联网厂商的设备如家电、智能硬件等可以接入鸿蒙系统实现万物互联，由此形成了庞大的鸿蒙生态链。我们看好生态链受益公司包括：(1) **芯海科技：**借助高精度 ADC、高可靠性 MCU、无线连接的核心产品，为物联网设备提供整体解决方案，截至 2023 年 8 月已成功导入 211 个鸿蒙智联项目商机，赋能 OEM 完成了 93 个产品的 Harmony OS Connect 认证，覆盖了 28 个产品品类，累计出货量近 2200 万台套。(2) **国科微：**今年 1 月 2 日宣布 8K 超高清显示芯片 GK6780V100 和普惠型智能视觉芯片 GK7205V510 双双通过 OpenHarmony 生态产品兼容性认证，2024 年将持续优化边缘侧 AI 战略布局。(3) **瑞芯微：**早在 2021/2022 年已发布 RK3566 和 RK3588 芯片产品，深圳触觉智能、优博终端等公司持续开发基于瑞芯微的鸿蒙开发板。(4) **恒玄科技：**公司第二代 Wi-Fi SoC 芯片 BES2600 系列率先支持鸿蒙操作系统的智能家居。此外，紫光展锐、全志科技等公司也在积极拥抱鸿蒙生态。
- **投资建议：**建议关注鸿蒙链 IC 设计公司：芯海科技、国科微、瑞芯微、恒玄科技。
- **风险提示：**鸿蒙生态建设速度不及预期；下游需求不及预期；技术研发风险；国内外政策和技术摩擦不确定性的风险。

信息披露

分析师与研究助理简介

陈海进，德邦证券所长助理兼 TMT 组组长、电子首席分析师，8 年以上电子行业研究经验，曾任职于民生证券、方正证券、中欧基金等，南开大学国际经济研究所硕士，电子行业全领域覆盖。

陈瑜熙，电子行业研究员，凯斯西储大学硕士，曾任职于方正证券，覆盖半导体模拟 IC、数字 IC、射频 IC 等领域。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准： 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅； 2. 市场基准指数的比较标准： A 股市场以上证综指或深证成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	类别	评级	说明
股票投资评级		买入	相对强于市场表现 20%以上；
		增持	相对强于市场表现 5%~20%；
		中性	相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
		减持	相对弱于市场表现 5%以下。
行业投资评级		优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上；
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间；
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平 10%以下。

法律声明

本报告仅供德邦证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络德邦证券研究所并获得许可，并需注明出处为德邦证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，德邦证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。